



반도체 식각장비  
제조업체, **브이엠(주)**

브이엠(주)

# 2024년 각 부문 경력/신입사원 채용

**브이엠(주)**은 국내 상장사 중 유일하게 반도체 식각 장비 국산화에 성공했고, 현재는 글로벌 TOP TIER 반도체 제조사인 SK하이닉스와 거래를 하고 있습니다.

본사는 경기도 이천에 위치하고 있으며, 2028년에는 용인 반도체 클러스터에 대규모 사옥을 지어 본사를 이전할 예정입니다.

아직은 회사 규모가 작지만, 반도체 식각 장비 시장의 중요성과 진입장벽 그리고 시장 규모를 고려하면

당사가 현재 추진하고 있는 해외 시장 진출과 신규 장비 개발을 통해 글로벌 반도체 장비 회사로 거듭날 것입니다.

당사는 대기업 수준의 임금과 복리후생을 제공하고 있고, 임직원 동기부여 차원에서 스톡옵션, 자사주 지급 등 차별화된 보상 제도로도 적극 운용하고 있습니다.

조만간 해외 시장 진출이 가시권에 진입할 것으로 예상되어 당사와 같이 성장할 수 있는 역량 있는 인재를 채용하고 있으니 많은 관심 바랍니다.

## 모집부문

모집분야	담당업무	자격요건 및 우대사항	근무지
공인회계사 또는 세무사	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 회계, 재무, 기획 업무</li> <li>- 내부감사</li> <li>- 회계결산(별도 및 연결회계)</li> <li>- 내부회계관리제도 운영</li> <li>- 회계/세무 이슈 검토 및 분석</li> <li>- 외부회계(K-IFRS 기준) 감사 대응</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5년이상 경력자</li> <li>- 대졸이상(4년)</li> <li>- 한국공인회계사(KICPA)자격증</li> <li>- 연봉 업계 최고대우</li> <li>- 대기업 수준 복리후생 제공</li> </ul> <p><b>[우대사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세무사 자격증</li> <li>- 대형 회계법인 경력자 우대</li> <li>- <b>어학능력(영어) 우대</b></li> </ul>	<p>서울 (삼성동 파르나스 타워) 또는 이천 본사</p>

<p>S/W 엔지니어</p>	<p>- 반도체 장비 제어(S/W)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신입</li> <li>- 대졸이상(4년)</li> <li>- Visual C, C++, C# 사용가능자</li> <li>- 연봉 업계 최고대우</li> <li>- 대기업 수준 복리후생 제공</li> </ul> <p><b>[우대사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보처리기사</li> <li>- <b>어학능력(영어) 우대</b></li> <li>- 전기/전자공학/컴퓨터/ 전산학과 등</li> </ul>	<p>서울 (삼성동 파르나스 타워) 또는 이천 본사</p>
<p>연구소 H/W 개발 엔지니어</p>	<p>- 반도체 장비 개발 및 연구원</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신입</li> <li>- 대졸이상(4년) / 개발, 연구원</li> <li>- 연봉 업계 최고대우</li> <li>- 대기업 수준 복리후생 제공</li> </ul> <p><b>[우대사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 석사이상</li> <li>- <b>어학능력(영어) 우대</b></li> <li>- 전기/전자/제어/물리/화학/ 재료/기계/ 컴퓨터/반도체 관련학과 전공자</li> </ul>	<p>이천 본사</p>
<p>연구소 기구설계 엔지니어</p>	<p>- 반도체 장비 설계</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신입</li> <li>- 대졸이상(4년) / 기구설계</li> <li>- AutoCad / Creo/ 3dCad 등 사용가능자 (설계)</li> <li>- 연봉 업계 최고대우</li> <li>- 대기업 수준 복리후생 제공</li> </ul> <p><b>[우대사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>어학능력(영어) 우대</b></li> <li>- 전기/전자/제어/물리/화학/재료/기계/ 컴퓨터/반도체 관련학과 전공자</li> </ul>	<p>서울 (삼성동 파르나스 타워) 또는 이천 본사</p>
<p>공정 엔지니어</p>	<p>- 반도체 장비 공정 개발</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신입</li> <li>- 대졸이상(4년)</li> <li>- 전자/물리/화학/ 재료/기계 등</li> <li>- 반도체 관련학과 전공자</li> <li>- 연봉 업계 최고대우</li> <li>- 대기업 수준 복리후생 제공</li> </ul> <p><b>[우대사항]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 석사이상</li> <li>- <b>어학능력(영어) 우대</b></li> </ul>	<p>이천 본사</p>

## ■ 공통 지원자격

- 남자의 경우 군필자 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자
- 서울, 인천, 중국지역 근무 가능자
- 외국어 가능자 우대
- 운전가능자 우대
- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 의거 대상자 우대
- 입사지원서의 내용이 허위인 경우 채용 통보 후에도 입사 취소
- 입사지원서 상단에 지원분야 반드시 기재요망

## ■ 복리후생

- 초, 중, 고, 대학교 입학 축하금 지원
- 어린이집, 유치원, 고등학교, 대학교 학자금 지원
- 본인, 배우자, 자녀, 부모 등 의료비 지원
- 매년 종합병원 정밀검진 실시(배우자 포함)
- 장기근속 포상
- 기념일 상품권 지급
- 기타 대기업 수준의 복리후생

## ■ 전형절차

STEP1  
서류전형  
(인사부서)

STEP2  
1차면접  
(실무 및 팀장  
면접)

STEP3  
2차면접  
(임원 면접)

STEP4  
채용검진  
(지정병원)

STEP5  
최종합격

※ 각 단계별 합격자에 한해 개별통보함  
※ 전형 내용 및 일정은 회사사정에 의해 변경될 수 있음

## ■ 제출서류

- 제출서류: 자소서, 졸업증명서, 성적증명서, 자격증 및 어학성적 사본 등

※ 채용절차의 공정화에 관한 법률에 채용여부가 확정된 이후 응시자가 채용서류의 반환을 청구하는 경우에는 본인임을 확인한 후 반환하며, (전자우편 및 첨부제출 자료 등은 해당되지 않습니다) 채용서류 반환의 청구기간 (최종합격자 발표일로부터 3개월)이 지난 경우 개인정보 보호법에 따라 채용서류를 파기함.

## ■ 접수기간 및 방법

- 접수기간: 2024년 5월 29일 화요일 ~ 6월 29일 토요일
- 접수방법: 메일접수 ([recruit@vmsemi.com](mailto:recruit@vmsemi.com))

## ■ 유의사항

- 담당자: 브이엠(주) 인사담당자 ([recruit@vmsemi.com](mailto:recruit@vmsemi.com) / Tel: 031-645-1153)